

重点关注！ 欧盟发布RoHS指令Pack 22豁免条款最终评估报告

原创 SGS RSTS SGS限用物质测试服务 2022-01-14 18:00

收录于话题

#RoHS

19个

戳 “SGS限用物质测试服务” >点击主页右上角...>设为星标

2022年1月13日，欧盟RoHS咨询项目Pack 22的最终评估报告正式发布。报告对附录III中的6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I和7(c)-II共计9项豁免条款的延期申请进行了评估并给出了建议，涉及钢合金、铝合金、铜合金、高温焊料、电子电气元件中的玻璃和陶瓷等多种电子电气产品中广泛应用的材料。**此外，报告中新增6(a)-II, 6(b)-III, 6(b)-IV, 7(c)-V, 7(c)-VI等5条豁免条款，同时详细列出了7(a)条款的7种应用场景，以帮助企业更有效地识别材料是否在豁免范围内。**

Pack 22咨询项目于2020年12月15日正式启动，涉及的豁免条款应用广泛，欧盟将根据此次评估报告的建议，在官方公报（EUOJ）发布最终的豁免条款更新指令，企业可参考此次评估报告所列内容进行产品调整，提前应对法规变化。

评估报告所列条款及有效期如下：

条款	豁免内容	有效期
6(a) 适用产品类别: 第8类体外诊断医疗器械	机械加工用钢中作为合金元素的铅，以及镀锌钢中的铅含量小于0.35%	2023.7.21
6(a) 适用产品类别: 第9类工业监控设备， 第11类		2024.7.21
6(a)-I 适用产品类别: 所有类别	机械加工用钢中作为合金元素的铅，含量小于0.35%	2024.7.21
6(a)-II 适用产品类别: 所有类别	作为合金元素的铅，在批量热处理镀锌钢部件中的含量不超过0.2%	2026.7.21
6(b)-I 适用产品类别: 所有类别	铝中作为合金元素的铅，含量小于0.4%，铅来自含铅铝废料	最终决定后的12个月
6(b)-III 适用产品类别: 所有类别	作为合金元素的铅，在铝铸造合金中的含量不超过0.3%，铅来自含铅铝废料	2026.7.21
6(b)-II 适用产品类别:	用于机械加工目的，铅作为一种合金，在铝合金中含量不超过0.4%	最终决定后的18个月

所有类别		
6(b)-IV 适用产品类别: 第1类大型家用电器	在加工用铝合金中作为合金元素的铅，用于1类大型家用电器的气阀中，含量不超过0.4%	2024.12.31
6(c) 适用产品类别: 所有类别	铜合金中的铅，含量不超过4%	2026.7.21
7(a) 适用产品类别: 该附录第24条豁免条款涵盖的应用以外的所有类别	高熔化温度型焊料中的铅（如铅含量超过85%的铅基合金焊料）（不包括豁免第24条的范围）	2024.7.21
7(a) 适用产品类别: 该附录第24条豁免条款涵盖的应用以外的所有类别	用于以下应用的高熔化温度型焊料中的铅（如铅含量超过85%的铅基合金焊料）（不包括豁免第24条的范围）： I) 用于连接芯片的内部互联，或半导体组件中其他元件和芯片的内部互联，其稳态或瞬态/脉冲电流大于等于0.1 A或阻断电压大于10 V，或芯片边缘尺寸大于0.3 mm x 0.3 mm II) 用于电气和电子元件中芯片连接的整体连接（指内部和外部），如果固化/烧结芯片连接材料的热导率大于35 W/(m*K)，且固化/烧结芯片连接材料的导电率应大于4.7 MS/m，且固相线熔化温度必须高于260 °C III) 用于制造元件的一级焊点（内部或整体连接-指内部和外部），以便随后使用二级焊料将电子元件安装到子组件（即模块或子电路板或基板或点对点焊接）上不会使第一级焊料回流。不包括芯片连接和密封 IV) 用于将元件连接到印刷电路板或引线框架的二级焊点： •用于连接陶瓷球栅阵列(BGA)的焊接球 •高温塑料二次成型(> 220 °C) V) 作为密封材料用于： •陶瓷封装或插头和金属外壳 •元件终端和内部子部件 VI) 用于在红外加热或高强度放电灯或烤箱灯中的白炽反射灯的灯部件之间建立电气连接 VII) 峰值工作温度超过200 °C的音频传感器	2026.7.21
7(c)-I 适用产品类别: 所有类别	电子电气元件中玻璃或陶瓷材料（电容中陶瓷介质除外）所含的铅，如压电设备或玻璃/陶瓷复合元件	2024.7.21
7(c)-V 适用产品类别: 所有类别	电子电气元件中具有以下功能的玻璃或玻璃基质化合物中含有的铅： •基于硼酸铅锌或硼酸铅硅玻璃体的高压二极管玻璃珠和晶圆用玻璃层的保护和电绝缘* •用于陶瓷、金属和/或玻璃部件之间的密封 •用于在<500 °C且粘度为10^{13,3} dPas的工艺参数窗口中进行连接（即“玻璃化转变温度”） •用作墨水等电阻材料，电阻率范围为1欧姆/平方至1兆欧姆/平方，不包括微调电位器** •用于微通道板(MCPs)、通道电子倍增器(CEMs)和电阻玻璃产品(RGPs)的化学改性玻璃表面	2026.7.21
7(c)-VI 适用产品类别: 所有类别	电子电气元件中具有以下功能的陶瓷中含有的铅（不包括第7(c)-II、7(c)-III和7(c)-IV涵盖的应用）： •压电钛酸铅锆(PZT)陶瓷 •提供具有正温度系数(PTC)的陶瓷	2026.7.21
7(c)-II 适用产品类别: 该附录第7(c)-I和7(c)-IV豁免条款涵盖的应用以外的所有类别	额定电压为交流125 V或直流250 V及以上的电容中陶瓷介质所含的铅	2026.7.21